

安徽芯动联科微系统股份有限公司

(安徽省蚌埠市财院路 10 号)



芯动联科

关于安徽芯动联科微系统股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
的上市委会议意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

二〇二三年四月

上海证券交易所：

贵所于 2023 年 2 月 14 日出具的上证科审（审核）〔2023〕60 号《关于安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委员会意见落实函》（以下简称“意见落实函”）已收悉。安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“芯动联科”、“发行人”、“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所列问题逐项进行认真讨论、核查与落实。现回复如下，请予审核。

本回复中简称与《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中简称具有相同含义，其中涉及招股说明书的修改及补充披露部分，已用楷体加粗予以标明。

本回复中若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本问询函回复中的字体：

意见落实函问题	黑体（加粗）
意见落实函问题的回复	宋体
回复中涉及对招股说明书补充的内容	楷体（加粗）

目 录

问题一	4
-----------	---

问题一

请发行人在招股说明书中补充披露自建封装测试生产线在经济性方面的考虑，对稳定产品良率的影响。

回复：

一、发行人补充披露情况

发行人已在招股说明书“附件六、募集资金具体运用情况”之“四、MEMS 器件封装测试基地建设项目”处补充披露了自建封装测试生产线在经济性方面的考虑，对稳定产品良率的影响。具体如下：

“4、自建封装测试生产线在经济性方面的考虑以及对稳定产品良率的影响

(1) 完善公司产业链环节，降低产品成本

公司主营业务为高性能硅基 MEMS 惯性传感器的研发、测试与销售，尚无封装产线。本次募投项目“MEMS 器件封装测试基地建设项目”拟投资建设一条 MEMS 器件封装测试生产线，具体建设内容包括两部分：一是建设一条先进的封装生产线，实现惯性传感器和压力传感器的封装生产，并可实现定制化封装；二是提升公司现有测试技术水平和扩大测试产线的产能，一方面通过购置新设备、研发新技术，使公司具备圆片级的测试能力，另一方面建设测试产线以及扩大现有产品测试产能，进而与封装产线的产能匹配，整体提高公司产品的生产效率，完善公司产业链。

根据公司募投项目规划，“MEMS 器件封装测试基地建设项目”从建成到投产共计 3 年，计划总投资 22,166.12 万元，其中固定资产等长期资产合计约 17,712.96 万元，占比约 80%。按照公司预计募集资金投入情况，根据公司现行会计政策测算，“MEMS 器件封装测试基地建设项目”自建成后资产折旧摊销金额呈现先增后降的趋势，并于第三年达到最大值，约 3,500 万元。

目前，公司封装工序交由专业厂商完成，2022 年公司采购封装服务金额为 764.13 万元，占主营业务成本的比重为 24.03%，封装费用是公司主营业务成本的重要组成部分。根据公司 2022 年委外封装数量以及封装费用计算，公司单件产品的封装费用约 54.68 元。以“MEMS 器件封装测试基地建设项目”全部长

期资产的最大年折旧摊销金额 3,500 万元计算, 当公司封装产品数量达到年产 64 万件时, 规模效应将抵消封测产线资产折旧摊销的影响, 降低产品的生产成本, 具备经济性。

(2) 提高公司产品的生产效率和交付能力, 提升公司的市场竞争力

目前, 公司正处于快速发展阶段, 随着公司客户数量的增加, 规模的扩大, 尤其是募投项目的实施, 将会进一步提升企业的生产能力。未来, 随着公司工业级惯性传感器和压力传感器产品的逐步量产, 其年均出货量相较于高性能惯性传感器产品的出货量会大幅增加, 公司的封装和测试需求也会大幅提高。

根据“MEMS 器件封装测试基地建设项目”的建设目标, 项目建成后, 公司封装产线的产能能够完全覆盖当前的产品封装数量, 并能够满足企业未来日益增长的封装需求。因此, 随着企业规模的不断扩大, 产品出货量的不断提升, 与委外封装相比, 经济性逐步凸显。

综上, 公司通过自建封装测试生产线, 在出货量达到一定规模时可以降低产品的生产成本, 同时也能够提高产品的生产能力和交付能力, 更好的满足客户的需求, 从而提升公司的市场竞争力。

(3) 对稳定产品良率起到促进作用

封装测试很大程度上影响着产品的性能, 对于产品能否与应用终端实现更好的融合起着重要作用。由于传感器的种类繁多, 应用领域也不同, 委外封装厂商需要根据不同产品种类和客户的需求不断调试、修改和适应参数, 不仅不能快速响应公司的需求, 同时由于产线参数调整等情况, 也会导致封装过程中出现产品质量问题, 进而对封装产品的良率产生一定影响。

公司通过自建封测产线, 可以根据不同产品的封装需求开展封装工作, 且因为公司的封测产线只面向自身产品需求, 因此能够保障公司产品出货的及时性。同时, 公司将产品工艺设计与封装工序反复调试, 相互契合, 能够提高生产效率, 实现对封装环节产品质量的自主把控, 提升产品品质。此外, 随着企业生产规模的扩大, 产品种类的增加, 尤其是工业级惯性传感器产品的量产, 也会使得企业整体的良率得到提升。

综上, 公司通过自建封装测试生产线, 既可以提高产品的交付能力, 也可以

实现对封装环节产品质量的自主把控，提升产品品质，对稳定产品良率起到促进作用。”

保荐机构总体意见

对本意见落实函回复中的发行人回复，本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

（本页无正文，为安徽芯动联科微系统股份有限公司《关于安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委会议意见落实函的回复》之盖章页）

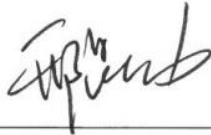
安徽芯动联科微系统股份有限公司
2023年7月12日



发行人董事长声明

本人已认真阅读安徽芯动联科微系统股份有限公司本次意见落实函回复的全部内容,确认本次意见落实函回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对上述文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

发行人董事长(签字):



邢昆山

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2023年4月12日



(本页无正文，为中信建投证券股份有限公司《关于安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的上市委会议意见落实函的回复》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 包红星 陈利娟
包红星 陈利娟



关于本次意见落实函回复的声明

本人作为安徽芯动联科微系统股份有限公司保荐机构中信建投证券股份有限公司的董事长，现就本次意见落实函的回复郑重声明如下：

“本人已认真阅读安徽芯动联科微系统股份有限公司本次意见落实函的回复的全部内容，了解回复涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本次意见落实函的回复不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。”

法定代表人/董事长签名：



王常青

